

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 10 月 6 日(06.10.2011)

(10) 国際公開番号
WO 2011/122023 A1

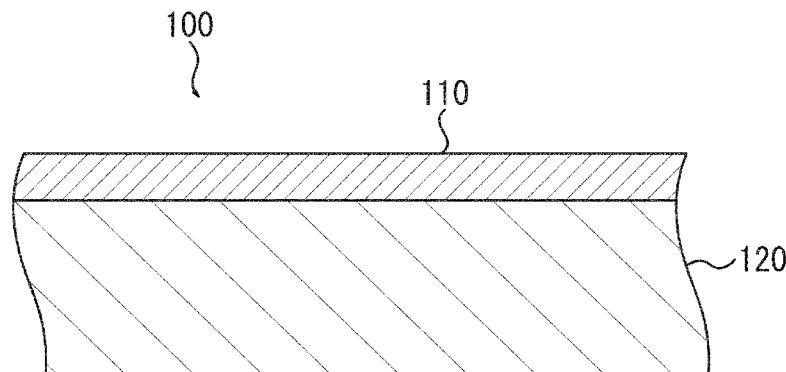
- (51) 国際特許分類:
B32B 27/36 (2006.01) *H05K 3/28* (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/001910
- (22) 国際出願日: 2011 年 3 月 30 日(30.03.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-080324 2010 年 3 月 31 日(31.03.2010) JP
特願 2010-102577 2010 年 4 月 27 日(27.04.2010) JP
特願 2010-161488 2010 年 7 月 16 日(16.07.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 谷口裕人 (TANIGUCHI, Hirohito) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人クレイア特許事務所 (CREIA IP ATTORNEYS); 〒5300047 大阪府大阪市北区西天満二丁目 6 番 8 号 堂島ビルディング Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: MOULD RELEASE FILM

(54) 発明の名称: 離型フィルム

【図1】



(57) Abstract: Provided is a mould release film that has embedding characteristics superior to previous PBT-type mould release films while preventing clinging between the circuit exposure film of a mould release layer and a cover lay (CL) film and between mould release layers, when the CL film is adhered to the circuit exposure film. The disclosed mould release film (100) is provided with a release layer (110) that includes, at least, a polybutylene terephthalate homopolymer (A) and a polybutylene terephthalate (PBT)/polytetramethylene glycol (PTMG) copolymer (B).

(57) 要約: 本発明の課題は、回路露出フィルムへのCLフィルム接着時において、離型層の回路露出フィルム及びCLフィルムへの密着および離型層同士の密着を防ぎつつ、従前のPBT系離型フィルムよりも良好な埋め込み性を得ることができる離型フィルムを提供することである。本発明に係る離型フィルム100は、少なくともポリブチレンテレフタレート共重合体(A)と、ポリブチレンテレフタレート(PBT)成分とポリテトラメチレングリコール(PTMG)成分との共重合体(B)とを含有する離型層110を備える。



WO 2011/122023 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正を受理した際には再公開される。(規則 48.2(h))